



2026 年 8 月 17 日

各 位

## 2030 年以降の銅箔生産能力増強の展望について

～市場拡大に応じ、新工場（マレーシア）設立により VSP 箔月産 5,000t、  
MicroThin 箔月産 1,200 万㎡までの生産体制へ～

当社（社長 池信省爾）は、高周波基板用電解銅箔「VSP™」とキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」について、2026 年 8 月 7 日付ニュースリリースにて 2030 年に向けての生産能力増強を発表いたしました。2030 年以降も AI・半導体市場の継続的な急成長が見込まれる中、お客様に対する安定した供給を継続するため、マレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN.BHD.)の近傍に新たに土地を取得し、2031 年以降に VSP 箔月産 1,200t、MicroThin 箔月産 400 万㎡の生産能力を持つ新拠点を設立することで、既存の生産能力と合わせて VSP 箔月産 2,600t、MicroThin 箔月産 1,200 万㎡とする計画を策定しております。

VSP 箔については、更なる市場拡大に応じて月産 5,000t までの生産能力体制を構築する計画も視野に入れております。

当社の高周波基板用電解銅箔「VSP™」は、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、サーバー、ルーター、スイッチ等の高性能通信インフラ機器に採用されております。足元は AI インフラ関連向けに HVLP5 グレード品が量産フェーズに移行し、ビッグテック各社での採用が進むなど市場での当社 VSP™の需要が急激に増加しており、今後も更なる拡大が期待されます。

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した  $1.5\mu\text{m}$ ～ $5\mu\text{m}$  の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化处理を組み合わせた製品であり、主に半導体パッケージ基板や光モジュール、スマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）に使用されており、データセンターやメモリー基板用途が増加、また光モジュールは AI サーバーへの採用に伴い今後も需要が伸長していくものと考えております。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■ 「MicroThin™」「VSP™」生産能力 （ご参考）

|                      | 2025<br>年度 | 2026<br>年度 | 2027<br>年度 | 2028<br>年度 | 2030<br>年度 | 2031<br>年度 | 2032<br>年度 | 2033<br>年度 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MicroThin™<br>(万㎡/月) | 490        | 490        | 520        | 600        | 800        | 1,000      | 1,000      | 1,200      |
| VSP™<br>(t/月)        | 720        | 840        | 1,000      | 1,200      | 1,400      | 2,000      | 2,600      | *2,600     |

\*取得予定地は月産 5,000t まで増強可能

以上

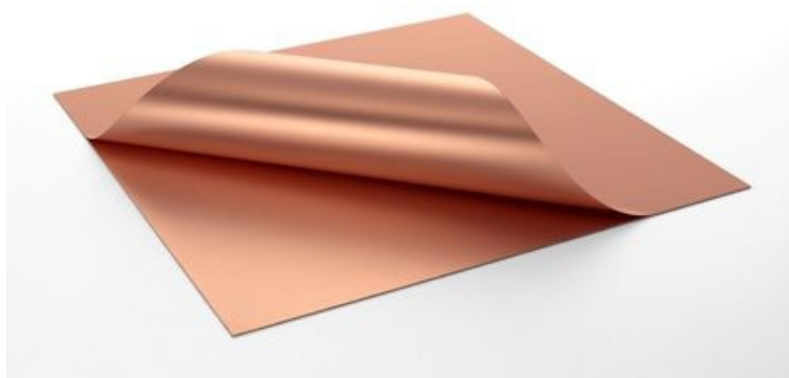
【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-5437-8028

Eメール：[PR@mitsui-kinzoku.com](mailto:PR@mitsui-kinzoku.com)

「MicroThin™」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18μm、12μm）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5μm～5μm）



汎用銅箔



VSP™

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴